

Express5800/T120h (3rd-Gen) スペック詳細

フレームモデル

2023年06月26日版

製品名称		Express5800/T120h	
モデル名		24x2.5型ドライブモデル	12x3.5型ドライブモデル
製品型名		N8100-2846Y	N8100-2847Y
CPU	Processor	インテル® Xeon® プロセッサー Bronze 3204(6C/6T, 1.90 GHz, 8.25MB, TDP 85W), Bronze 3206R(8C/8T, 1.90 GHz, 11MB, TDP 85W), Silver 4208(8C/16T, 2.10 GHz, 11MB, TDP 85W), Silver 4210R(10C/20T, 2.40 GHz, 13.75MB, TDP 100W), Silver 4214R(12C/24T, 2.40 GHz, 16.5MB, TDP 100W), Silver 4215R(8C/16T, 3.20 GHz, 11MB, TDP 130W), Gold 5218R(20C/40T, 2.10 GHz, 27.5MB, TDP 125W), Gold 5220R(24C/48T, 2.20 GHz, 35.75MB, TDP 150W), Gold 5222(4C/8T, 3.80 GHz, 16.50MB, TDP 105W), Gold 6226R(16C/32T, 2.90 GHz, 22MB, TDP 150W), Gold 6230R(26C/52T, 2.10 GHz, 35.75MB, TDP 150W), Gold 6238R(28C/56T, 2.20 GHz, 38.5MB, TDP 165W), Gold 6246R(16C/32T, 3.10 GHz, 35.75MB, TDP 205W)	
	標準搭載数 / 最大搭載数	0/2	
	コントローラ・ハブとの接続	DMI3 (8GB/s)	
	インテル® 64	対応	
	インテル® バーチャライゼーション・テクノロジー	対応	
	インテル® ハイバースレディング・テクノロジー	対応 (Xeon Bronze 3204, 3206Rは除く)	
	インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー	対応 (Xeon Bronze 3204, 3206Rは除く)	
	CPUソケット形状	LGA3647	
ホットプラグ	-		
冷却方式	ファンなしヒートシンク		
チップセット	インテル® C622 チップセット		
メモリ	搭載容量 標準 / 最大	標準搭載なし(セレクトابلオプション) / Registered DIMM : 1.5TB (24x 64GB)	
	メモリソケット数	24	
	増設単位	1	
	搭載メモリ	DDR4-2933 Registered DIMM (8/16/32/64GB)	
	最大動作周波数	2933MHz (CPU毎の最大動作周波数はシステム構成ガイドを参照願います)	
	メモリバス帯域(/チャネルあたり)	23.4GB/s	
	メモリアクセス方式	インディペンデントチャネルアクセス方式 (メモリ実装方法/BIOS設定に応じて12wayインターリーブをサポート)	
	誤り検出・訂正	ECC, x4 SDDC, DDDC, ADDDC	
	メモリスペアリング	対応	
	メモリミラーリング	対応	
	ホットプラグ	-	
	モジュールピン数	288 ピン	
動作電圧	1.2V		
バッファ機能	対応		
補助記憶装置	ドライブベイ	内蔵標準	-
		内蔵最大	2.5型HDDケージ(標準搭載+2x N8154-109)選択時 HDD: SATA 48TB (24x 2TB), SAS 57.6TB (24x 2.4TB) SSD: SAS 76.8TB(24x3.2TB)
		ホットスワップ	-
	インタフェース規格とRAID構成		対応
	光ディスクドライブ	SATA 6Gb/s(SW RAID):RAID 0/1/10(オンボード), SATA 6Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション), SAS 12Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション)	
	FDD	内蔵/外付ドライブ接続 (オプション) *1 オプション: Flash FDD (1.44MB) *2	
	拡張ベイ	2x 5.25型デバイスベイ + 1x DVDベイ	
拡張スロット	対応スロット	1CPU構成 2x PCI Express 3.0 (x16レーン, x16ソケット) (フルハイト, 290 mm サイズ) 2x PCI Express 3.0 (x4レーン, x8ソケット) (フルハイト, 290 mm サイズ) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (RAIDコントローラ専用)	
		2CPU構成 4x PCI Express 3.0 (x16レーン, x16ソケット) (フルハイト, 290 mm サイズ) 2x PCI Express 3.0 (x4レーン, x8ソケット) (フルハイト, 290 mm サイズ) 2x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (フルハイト, 290 mm サイズ) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (RAIDコントローラ専用)	
		PCI Express 1.1, 2.0, 3.0	
グラフィックス	搭載チップ / ビデオRAM	マネージメントコントローラチップ内蔵 / 16MB	
	グラフィック表示 と 解像度	1677万色: 640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,920x1,080 5x USB3.0(2x前面(TypeA), 2x背面(TypeA), 内部(TypeA)), 1x USB2.0(内部(TypeA)), 1x アナログRGB (ミニD-Sub15ピン), 1x シリアルポート(RS-232C規格準拠/D-Sub9ピン, シリアルポートA, 1x背面), 4x 1000BASE-T LANコネクタ (1000BASE-Tのみ対応, RJ-45, 4x 背面)*14 , 1x マネージメント専用LANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応, RJ-45, 1x 背面)	
ネットワーク	実装形式	オンボード	
	コントローラ	1x Intel C622 Chipset内蔵	
	チーミング	対応 (オプションボードとの組み合わせはシステム構成ガイドを参照願います)	
	FEC / GEC	対応	
	ジャンプフレーム	対応 (Linuxの対応状況は、NECコーポレートサイトのLinuxドライバ情報をご参照ください)	
リモートマネージメント	PXE / iSCSI ブート	PXEブート: 対応, iSCSIブート: 非対応	
	コントローラ	BMC	
WHEA(Windows Hardware Error Architecture)		Marvell PHY	
キーボード / マウス		対応	
BIOS		標準添付	
BIOS Version (出荷当初)		American Megatrends Inc. Aptio ®	
BMC Firmware Revision (出荷当初)		System ROM U31 v2.32 (最新のバージョンはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)	
System Sleep State		2.14(最新のリビジョンはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)	
冗長電源		S0, S5	
冗長ファン		対応 (オプション, ホットプラグ可)	
筐体デザイン		対応 (オプション, ホットプラグ可)	
外形寸法 (幅x奥行きx高さ) *9		5Uタワーマウント	
質量 (最小/ 最大)*4		174.0mm × 648.0mm × 462.5mm ( 突起物含まず) 21.0kg / 41.0kg	
電源		標準搭載なし(セレクトابلオプション) AC電源ユニット(N8181-159/160)	
		500W/800W 80 PLUS® Platinum 取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC100-120V/200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) AC電源ユニット(N8181-161)	
		800W 80 PLUS® Titanium 取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC200V-240V±10%, 50/60Hz±3Hz AC電源ユニット(N8181-162)	
		1600W 80 PLUS® Platinum 取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC200V-240V±10%, 50/60Hz±3Hz	
消費電力(100V最大構成時, 最大電力)		908VA / 899W (800W 電源最大値)	
消費電力(200V最大構成時, 最大電力)		1756VA / 1753W	1628VA / 1625W
発熱量		6310KJ/h	5850KJ/h
省エネ法(2021年度基準)に基づくエネルギー消費効率*16		Xeon 3204 Proccesor 以外 14.7 (区分 2) Xeon 3204 Proccesor 11.7 (区分 2)*17	
音量	音圧レベル (待機時 / 高負荷時) *11	31dBA / 32dBA	
温度条件	測定方式	ISO7779基準, 傍観者位置測定 (床: 1.5m, サーバとの距離: 1m), サーバ設置(床: 0.75m), 環境温度23℃ 動作時: 10~35℃(条件付きで5~40℃/45℃対応可) *13, 保管時: -30~60℃	
湿度条件		動作時: 8~90%, 保管時: 5~95% (動作時/保管時ともに結露しないこと)	
ハードウェア認証規定		VCCI クラス A	
OS認証		Windows Logo Program, Red Hat Certified Hardware	
主な添付品		スタートアップガイド、保証書、安全にご利用いただくために、ベゼルロックキー×2、キーボード、マウス	
無償保証内容		3年オンサイト保守サービス(月~金, 9:00~18:00, 原則翌営業日対応, 国民の祝日および年末年始等のNEC指定日を除く)	
インストールOS		3年パーツ保証	
サポートOS	NECサポート	Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2019 Standard , Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2022 Standard , Microsoft® Windows Server® 2022 Datacenter, Red Hat® Enterprise Linux® 7.7以降 *5, Red Hat® Enterprise Linux® 8.1以降 *5	
		VMware ESXi™ 6.5 Update3, VMware ESXi™ 6.7 Update3, VMware ESXi™ 7.0 以降, VMware ESXi™ 8.0 以降	
動作確認OS *6		最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux on Express5800」を参照願います	

**注意事項**  
拡張スロット 搭載可能なボードの奥行きはFull Height PCI: ロングサイズ = 312mmまで, ショートサイズ = 173.1mmまで Low Profile PCI: MD1 = 119.9mm まで, MD2 = 167.6mm まで を示します  
騒音値/電力 騒音値、電力に記載されている待機時とはOS起動時ログイン前の状態を示す

**注釈**  
\*1 内蔵DVD-ROMまたは内蔵DVDSuperMULTIを全システムに搭載しない場合、保守時およびOS再インストール時に備えて外付DVD-ROMをシステムで最低1式は必ず手配してください。  
\*2 必要に応じて手配してください。主な用途については「Flash FDD製品概要と利用ケース」のシステム構成ガイドをご参照ください。  
\*4 最小構成(24x2.5型ドライブモデル : 1x CPU, 1x HDD, 1xメモリ, 1x 電源ユニット)  
\*5 サポートサービスの提供を受けるにはNECよりLinuxサービスセットの購入が必要です。同一メジャーバージョン内での対応となります。  
\*6 BTOインストール不可。NECは動作確認情報のみ提供いたします。最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux On Express5800」を参照願います。  
\*9 防塵ベゼル実装時の外形寸法については、システム構成ガイドの<フロントベゼル>の項を参照願います。  
\*11 特定構成での騒音値(2xCPU(Gold 5118), 2x 16GB Memory, 1xRAIDコントローラ, 冗長FAN構成, 2x800W電源)  
\*13 40°C/45°C環境においてそれぞれ構成制限及び環境制限があります。詳細はシステム構成ガイド「リファレンス」の「40°C/45°C対応についての注意事項」をご参照ください。  
\*14 100BASE-xx,10BASE-xlは非対応です。  
\*16 エネルギー消費効率とは、中央演算処理装置、補助記憶装置及び主記憶装置の消費電力あたりの性能を幾何平均して得られる数値です。  
\*17 本製品は、省エネ法(2021年度基準)を未達成(100%未満)となります。